格兰康希通信科技（上海）股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案

为践行以“投资者为本”的发展理念，提高上市公司质量，树立良好市场形象，助力市场信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司于 2024 年 4 月 23 日发布《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，于 2024 年 8 月 26 日发布了《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》，对方案的实施情况进行了中期评估。2024 年公司通过切实地履行《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，在提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，稳定股价等方面取得一定成效。现将行动方案年度执行情况评估公告如下，并基于 2024 年的实际情况制定《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，以及制定能进一步实现经营提质增效、提升股东回报能力的相关举措。具体如下：

一、聚焦经营主业，深耕 Wi-Fi FEM 芯片设计领域

公司自成立以来，专注于在射频前端芯片领域的研发与设计工作。致力于研发高性能、高线性度、高可靠性的 Wi-Fi 射频前端芯片及模组。经过多年持续研发投入与技术积累，公司目前已形成 Wi-Fi 5、Wi-Fi 6/6E、Wi-Fi 7 等完整 Wi-Fi FEM 产品线组合。产品在线性度、工作效率等主要性能指标上达到行业领先水平。公司多款 Wi-Fi FEM 产品通过博通、高通、联发科、瑞昱等多家国际知名 Wi-Fi 主芯片（SoC）厂商的技术认证，纳入其发布的产品配置方案的参考设计。

2024 年公司实现营业收入 52,278.64 万元，同比增长 25.98%，创营收新高。

2024 年，公司持续深耕 Wi-Fi 技术领域，Wi-Fi 7 系列产品表现抢眼，通过不断迭代升级，细分市场份额稳步增长。可线性化系列产品在与 DPD 算法协同工作时，展现出卓越的 EVM 性能，实现超低功耗，为多 MIMO 配置的 Wi-Fi 7 网络设备营造良好的散热环境。

在射频前端芯片相继获得高通、联发科 Wi-Fi7 平台认证后，公司于 2024 年 6 月，成功与美国知名 SOC 主芯片厂商博通达成合作，数款产品正式进入博通 Wi-Fi7 平台的参考设计。这一突破不仅彰显了公司的技术实力，也为在高端 Wi-Fi 芯片市场竞争中增添了重要筹码，为未来进一步占领国际市场份额奠定了坚实的

基础。

2024年，公司陆续推出了工业IoT产品，其中KCT8103L在《电子发烧友》与慕尼黑华南电子展联合主办的2024第十一届中国IoT大会上，荣获“IoT年度创新产品奖”。公司还持续提出星闪射频前端解决方案，并与国内星闪SoC主芯片厂商紧密合作进入其参考设计。

由于Wi-Fi 7技术的领先性，在出海进程中，公司子公司遭遇全球射频前端行业龙头企业Skyworks Solution Inc.发起的专利诉讼和337调查，起诉公司销售的Wi-Fi射频前端模块产品侵犯其5项专利权。公司高度重视本次专利诉讼和337调查，迅速组建境内外专业律师团队积极应对，全力以赴，坚决捍卫自主研发成果，维护公司权益不受侵害。截至本公告日，对方已撤回5项涉诉专利中的3项，其余2项专利仍处涉诉及调查之中。。337调查预计2025年年中进入庭审准备及正式开庭阶段，具体进展情况请关注公开披露信息。

与此同时，公司在其他三个研发方向持续发力，成果显著：（1）低空经济领域，超高效率、大功率无人机产品研发送样进展顺利；（2）工业物联网方向，IoT产品顺利导入Wi-Fi Halow平台，与客户协同发展WiSUN协议，为工业物联网领域提供了稳定的通信保障；（3）V2X方面，C-V2X产品成功通过客户认证，与汽车模组厂商达成战略合作。

展望2025年，公司将巩固已经积累的护城河优势，聚焦主营业务，丰富产品矩阵，持续拓展公司业务，不断强化品牌形象。

二、重视研发投入，持续技术创新

作为科技创新企业，公司高度重视自主创新，持续对现有产品线进行完善与升级，并不断拓展新的科研方向。2024年，研发投入达10,765.20万元，同比增长71.00%，占公司营业收入的20.59%；研发人员数量合计96人，同比增加15人，占公司总人数的53.93%，研发投入和研发人员数量均创历史新高。截至2024年12月31日，公司累计获得发明专利21件，实用新型专利13件，软件著作权6件、集成电路布图设计专有权等其他类知识产权44项。研发投入持续保持高速增长，公司的研发能力得到持续提升，研发人员队伍得到持续扩大，现有产品性能得到持续提高，研发产品种类得到持续拓宽。

2024年，公司共涉及重大在研项目9个，涵盖Wi-Fi 5、Wi-Fi 6、Wi-Fi 7、手机Wi-Fi、IoT、V2X、低空等射频前端芯片及模组，新一代超高效率高带宽的射频前端架构研究，新一代高性能高集成度射频前端模组封装技术及应用等方面。截至目前，各项目研发进展顺利，未来有望进一步丰富公司产品品类，拓宽产品应用领域。公司将持续以市场需求为导向，加强研发项目的管理与投入，注重提高研发投入的产出效益。

项目名称	2024年主要研发项目计划	2024年进展
网通 Wi-Fi FEM 研发、迭代及产品化	前几代协议产品的成本极致优化与性能突破，最新 Wi-Fi 7 协议一代产品的技术升级与突破，实现与业界领先厂商齐头并进的新技术、新产品，并实现产品化。	Wi-Fi 6 产品的高性能、高性价比和低成本的产品线均已实现研发到产业化转变。部分 Wi-Fi 7 产品型号与主流 SoC 厂商进行参考设计深度合作，与终端客户建立了紧密的合作关系。Wi-Fi 7 技术升级迭代，研发实现高线性度、高功率、超高效率、超宽带等多研发领域的技术突破。
手机 Wi-Fi FEM 研发及产品化	研发应用于高端手机的 Wi-Fi 5/Wi-Fi 6/Wi-Fi 7 FEM，进一步丰富产品线。	Wi-Fi 6、Wi-Fi 7 产品现已完成仿真迭代，Wi-Fi 5 晶圆量产流片，部分型号完成芯片成品制造等，实现客户送样评估。
泛 IoT 射频前端芯片及模组	拓展泛 IoT 射频前端芯片产品，利用公司特有的高性价比 RF CMOS 工艺技术积累，结合砷化镓模拟电路的新技术突破，满足客户对高品质无线连接的需求。	聚焦 SubGHz 与 C-V2X 频段，助力近年来非常热的 WiFi Halow、WiSUN、V2X 和低空飞行器等物联网、车联网新兴无线通信协议，广泛应用于智能电表、智能安防、智慧城市、车-路-人-云互联互通；并且都在与相关领域的主流主芯片厂商进行参考设计战略合作认证。
新一代超高效率高功率的射频前端架构研究	研发适用于高功率、超高效率的下一代射频功率放大器及其组成的射频前端模组；采用片上 Doherty 架构并实现媲美于行业领先厂商的产	大客户定制产品，同步对突破性技术进行预研，现处于开发阶段，已完成仿真迭代，晶圆量产流片。

项目名称	2024 年主要研发项目计划	2024 年进展
	品性能。	
新一代高性能高集成度射频前端模组封装技术及应用	研发适用于移动终端的高性能高集成度射频前端模组封装技术，完成移动终端类产品的升级迭代。	为适应移动终端领域产品小型化、高集成、高效率的技术特点，针对新型封装技术展开产品开发，现已完成仿真迭代，晶圆量产流片以及工程样品封装测试阶段。

2025 年，公司将坚定不移地加大在核心产品及核心技术领域的研发投入，持续引进业界高质量技术人才，践行以市场和技术双轮驱动为核心的发展战略。紧密围绕客户需求，推动公司产品创新，不断满足市场日益增长的需要。同时，通过产品创新，进一步激发公司的研发创新能力，提升市场占有率，并实现公司价值的全面提升。在深入实施技术领先战略的过程中，强化高质量发展的基础支撑，夯实公司在 Wi-Fi 7 射频前端芯片领域的竞争优势。同时，不断优化技术架构，提升产品性能，确保产品质量和稳定性达到国际先进水平，为全球用户带来更加便捷、高效的无线连接体验。2025 年主要研发项目计划如下：

项目名称	2025 年主要研发项目计划
网通 Wi-Fi FEM 研发、迭代及产品化	Wi-Fi 7 协议产品的成本极致优化与性能突破，最新 Wi-Fi 8 协议一代产品的技术升级与突破，实现与业界领先厂商齐头并进的新技术、新产品，并实现产品化。
手机 Wi-Fi FEM 研发及产品化	研发应用于高端手机、平板、学习机、POS 机等移动终端设备的 Wi-Fi 5/Wi-Fi 6/Wi-Fi 7 FEM，进一步丰富产品线。
泛 IoT 射频前端芯片及模组	拓展泛 IoT 射频前端芯片产品，利用公司特有的高性价比 RF CMOS 工艺技术积累，结合砷化镓模拟电路的新技术突破，聚焦低空经济、C-V2X 智能车联网、星闪低功耗蓝牙等应用领域，着手研发一系列泛 IoT 射频前端产品，满足各领域客户对高品质无线连接的需求。
新一代超高效率高功率的射频前端架构研究	研发适用于高功率、超高效率的下一代射频功率放大器及其组成的射频前端模组；大客户定制产品进行性能迭代并完成产业化，

项目名称	2025 年主要研发项目计划
	实现媲美于行业领先厂商的产品性能。
新一代高性能高集成度射频前端模组封装技术及应用	为适应移动终端领域产品小型化、高集成、高效率的技术特点，针对新型封装技术展开产品开发，并将该技术成功应用于手机 Wi-Fi FEM 研发及产品化，最终实现移动终端类产品的迭代升级。

三、完善公司治理，强化“关键少数”的责任担当

公司现已建立以股东大会、董事会、监事会、独立董事和高级管理人员为核心的法人治理架构，形成了权责明确、运转协调、制衡有效的公司治理架构，为公司高效、稳健、规范经营提供了制度保证。

2024 年，公司积极响应独立董事制度改革相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，对《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《内部审计管理制度》进行了修订；制定了《独立董事专门会议工作制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《委托理财管理制度》。为确保独立董事的履职效能，公司设立了独立董事专门会议机制，进一步强化了独立董事对公司的监督体系，促进公司治理结构的完善和优化。

2024 年公司董监高参与多期上交所、上海证监局、中国上市公司协会等监管机构举办的各种培训，积极学习证券市场相关法律法规和证券市场知识，不断提升自律意识，推动公司持续规范运作。2024 年 3 月，公司针对内部董监高、中层以上管理者举行《上市公司规范运作培训宣导会》，就信息披露、对外发言、保密义务、交易与关联交易、交易权限概述、重大信息报告流程等进行了详细的培训及宣导。公司未来亦将全力支持董监高积极参与相关培训。

2025 年，公司将按照新《公司法》的相关规定，拟取消监事会，由董事会审计委员会履行监督职能。公司监事会工作将围绕“平稳过渡、职责衔接、合规保障”三大核心展开，确保监督职能无缝转移，维护公司治理连续性与股东权益。有效推动公司治理结构的进一步优化，实现从传统监事会监督模式向审计委员会主导的治理模式的顺利过渡。

公司将持续完善其他内部控制和治理建设，密切关注政策动态，积极学习研究新规，结合公司实际情况和发展需求，不断修订完善相关内部制度，并大力推进落实。继续加强董监高的培训工作，确保管理层能够学习掌握最新的法律法规知识、理解监管动态、不断强化合规意识，以推动公司董监高树立合规意识、履职尽责，赋能“关键少数”角色引领企业持续、稳定发展。

四、加强投资者沟通和监管层沟通，健全投资者沟通机制

公司高度重视信息披露工作，通过信息披露提升公司治理水平、增强市场透明度、树立良好企业形象。2024年，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司信息披露管理相关制度的规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、有效地披露了公司定期报告、临时公告等重大信息。后续，公司将继续严谨、合规地开展信息披露工作。

为了实现公司与投资者之间更深层次的理解、信任与合作，切实保障投资者权益，通过多元化渠道有效传递公司价值。公司设置了投资者关系专门电话热线和电子邮件，及时回复投资者邮箱以及“上证e互动”平台的问题，并将市场关注话题和投资者建议及时呈报管理层，形成公司与资本市场双向沟通机制，实现资本市场助力上市公司的质量提升。公司积极组织投资者调研活动，邀请公司高管或相关负责人与投资者面对面交流，回答投资者关心的问题，增进双方的沟通和了解。

2024年，公司已建立投资者意见征询和反馈机制并将在未来持续完善，提高信息披露的透明度，深入了解投资者的实际诉求和意见，并通过各种渠道进行针对性回应。在合规的基础上，让投资者全面及时地了解公司的经营状况、发展战略等情况，加强与投资者的交流与沟通，增进投资者对公司的信任与支持。

2024年，公司除现场参与上交所多场次现场培训，同上交所科创板公司管理部汇报企业发展的各项进展及痛点难点之外，还多次参与上交所、上海证监局相关活动。2024年2月，上交所科创板专项工作组与公司进行调研座谈交流；2024年5月，公司参加上海证监局、浦东金融局举办的“上市公司高质量发展服务月”系列活动之集成电路专场座谈会；2024年9月，公司积极参加上海证监局《关于创设股票回购、增持专项再贷款相关事项》的线上调研会；2024年12月，

上海证监局至公司现场调研，公司向监管层汇报了国际形势、行业竞争、企业发展等多方面内容。公司通过不断加强与监管层的沟通，熟知当下监管动态，为公司经营、股东利益、投资者回报等各项工作的顺利开展指引方向、赋能增效。

2025年，公司将继续通过常态化业绩说明会、线上交流、现场参观座谈、上证e互动平台、投资者热线电话、投资者关系邮箱及股东大会等多种渠道和方式，积极与投资者互动交流，回应投资者关切，及时、准确向投资者传递公司经营发展信息，促进投资者对公司价值的认同和信心，并认真倾听、吸收各类投资者的意见、建议，通过向董事会、管理层反馈来自资本市场的信息，保证公司董事会、管理层及时了解市场变化与关切，提升经营管理决策的科学性、合理性。公司将开展至少3次业绩说明会；不定期参与策略会、反路演、电话会议或线下调研等交流活动。

五、持续推进两轮回购，完善投资者回报机制

2024年，公司实际控制人、董事长、总经理 PING PENG 先生基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期价值的认可，为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，落实“提质增效重回报”行动方案，两次提议回购公司股票。公司及董监高积极响应，经相关会议审议后开始实施。第一轮回购主要用于股权激励或员工持股计划，旨在充分调动员工的积极性；第二轮回购着重于维护公司价值及股东权益，以增强二级市场投资者信心。第二轮回购资金来源不仅包括自有资金，还充分利用国家对上市公司回购股票的支持政策，引入了专项回购贷款资金。截至本公告日，两轮回购均已完成，累计回购股份428.53万股，占总股本的比例为1.01%，回购成交的最高价为16.10元/股，最低价为12.71元/股，用于支付资金的总额已超人民币6,000.00万元。以实际行动切实维护全体股东利益，增强投资者信心。

通过制定并实施2024年度“提质增效重回报”专项行动方案，公司保持了高质量的发展，一方面专注主营业务，持续优化管理和公司治理，另一方面通过不断优化投资者关系管理，切实保障了投资者的合法权益。2025年，公司仍会在适当时机，选择回购公司股份，并将通过良好的经营管理、完善的公司治理积极回馈广大投资者，尽上市公司的责任与义务，以实际行动切实维护全体股东利益，

增强投资者信心。

六、投资相关领域，完善产品线联动与协同

2024 年公司凭借对行业前沿技术的敏锐洞察，通过实施拓宽产品研发广度和投资相结合的发展策略，进一步完善产业链布局。在 UWB、卫星端侧、智能控制和整体解决方案等领域投资多家企业，助力公司产品线的多元化发展，为企业做大做强寻求新的着力点。

公司与知名投资管理机构金鼎资本旗下纵横金鼎正式签订投资协议，共同投资组建青岛执恒创业投资合伙企业（有限合伙），并完成首个项目的投资，投资项目为安徽欧思微科技有限公司（以下简称“欧思微”），主营业务为超宽带（UWB）及汽车毫米波雷达 SoC 芯片设计。

公司参投上海凡麒微电子有限公司，该公司专注于射频前端芯片的设计开发，应用于智能手机、智能穿戴、卫星通信、汽车电子、工业互联领域；核心产品为终端通信的射频前端模组，以架构创新为突破口，为客户提供全系列具有竞争力的射频前端模组产品。

公司参投的另一家公司为深圳市芯中芯科技有限公司（以下简称“芯中芯”），业务方向主要集中在家电、音频等领域。其面向智能物联网市场，提供基于 Wi-Fi、音频 DSP、Bluetooth、AIoT 等技术的智能控制模块与解决方案，产品广泛应用于智能家居、智能穿戴、智能健康等各类智能物联网相关的智能终端。2024 年以来，AI 及算力技术不断蓬勃发展，芯中芯亦相继推出相关的产品线，其中涵盖 AI 玩具、AI 眼镜、AI 智能监控系统等，并将跟随技术演进，不断进行更新、迭代。

公司正凭借对行业前沿技术的敏锐洞察，研发与投资并举，积极拓宽产业版图。未来，公司将持续关注行业优质企业与创新项目，进一步完善产业链布局，践行可持续发展、实现长期战略目标。

七、其他事宜

公司将一如既往地落实 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，每半年披露行动方案的实施进展及效果，积极与投资者展开沟通与交流，并基于具体措施的

执行情况以及投资者建议和反馈，不断优化、落实行动方案。同时，公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司董事会

2025年4月28日